

Singulation System

Model LSG 1040



**High-speed package dicing system
using laser technology**

高速激光切割设备

- 支持多种形状的激光切割机
- 为每种产品提供最佳切割工艺方案
- 通过双激光和双工作台，实现高速切割和高生产效率



SPECIFICATION

Items		Unit	Description					
机型		—	LSG1040					
框架尺寸	长度	mm	230—300					
	宽度	mm	62—100					
	厚度	mm	2 (Max.)					
产品尺寸	最小	mm	1×1					
	最大	mm	40×40					
基板翘曲量		—	2mm／300mm (Max.)					
激光		—	2 Heads, Twin tables					
外形尺寸	机类型	module	Cut Engine	Offload	Vacuum pump	Dust collector for laser	Dust collector for package collector (×2)	Chiller
	宽度	mm	2,325	1,500	1,000	900	627	445
	纵深	mm	1,935	1,760	900	850	588	400
	高度	mm	2,195	2,015	1,873	1,835	1,459	610
重量		ton	5.7		0.8	0.34	0.14	0.04
框架供给部	类型	—	Slit magazine					
	数量	pcs	4 (Max.) 当弹匣宽度为115毫米时					
产品收纳机构	类型	—	Bulk bin (round type)					
	数量	pcs	4 (Max.)					
吸嘴数量		—	2units × 11pcs					
品种转换件更换时间		min	20					
产品传送方式		—	Vacuum					
产品处理能力		UPH	170,000					

- 以上数据为本公司标准机型时的规格
- 以上规格根据实际需要会有改良变更的可能
- 如有其他特殊规格要求，另行协商



东和半导体设备（上海）有限公司
中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A
TEL 021-6888-6860

Website



Inquiry contact



TOWA（本公司商标），是TOWA株式会社的商标或注册商标。

Overseas Sales Contacts

Japan/Headquarters TOWA Corporation	Philippines TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.
China TOWA (Shanghai) Co., Ltd. TOWA Taiwan Co., Ltd.	Thailand TOWA THAI COMPANY LIMITED
Korea TOWA Korea Co., Ltd.	India TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED
Singapore TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.	Germany TOWA Europe GmbH
Malaysia TOWA MALAYSIA SALES & SERVICES SDN. BHD.	Netherlands TOWA Europe B.V.
	the United States TOWA USA Corporation